

S i C実装にはA g焼結不可欠に

ペーストが有力とした。無加圧下の250℃で接合するとマイクロボラスが形成され、ネットワーキ化されて安定して50MPaの高い接合強度が実現できたという。また、熱伝導率も140W/mKを実現、300℃までの高温試験でもク

が、温度サイクル試験をしてもなんら特性変化は見られず、信頼性に問題がないとした。

菅沼教授は3年前からAg薄膜を使った「ストレスマイグレーション接合」を提案していることも明らかにした。1μm厚のAg蒸

絶縁基板はSiNが本格登場

格登場

とDBA基板の組み合わせは極めて安定した構造だという。

A g焼結体は特に2種類
の大きさのものを組み合わせたハイブリッド型のA g

同開発した熱硬化イミド型のナノコンポジット封止材との効果も確認済みとした。A g焼結後、マイクロポーラス内に同封止材が入り込み、モールディング後にしっかりと接合されるイメージだ。同材料を使い、i CのSBDを試作した。

レハルでの表面の隆起物が生じて完璧な接合が可能になるという。

今後は、さらに接合メカニズムの基礎理解を深め、なんらかの共通の指針や新たな評価技術が求められるとした。

(副編集長 野村和広)

エプローブ
で **検索**

マイクロ波プローブ・4探針
プローブ・シート抵抗測定器

<http://www.nps-i.co.jp>

品種少量生産の「スペシャル」として、将来にわたって同社しか対応できない基本実装ニーズを獲得できる体制を構築する。

特にスマホを含む「ユニケーション分野」が4割近い増収となっている。

16年1～3月期の受注環境は、ノートブックの需要

新型スマホが牽引

分野の全3分野において売上高がそれぞれ2桁増収し、減収を見込んでいる。

一、東三陸支所。二、二二二二

●エルナー
楔を建設した。これにより
一貫生産工程を導入するこ

とが可能になった。なお、

15年全社投資のうち回路事業による割合を充てた。

マレーシア工場での生産

8-1、☎045-470

17251)は、2016
 手の全社設備投資額として
 ジアでの車載用基板の受注
 拡大を旨指すのは、東南ア

15億〜16億円（前年は17億
が足元で拡大している動き

円)を計画している。

に対応するもの。ビルドアップに去る道を下る。

を狙い、マレーシア工場の

増設工事に15年内から着
注拡大を目指す。今後、雪

パガロンの四半期売上高と製品構成

四半期	売上高 (億台湾ドル)	その他 (%)	コンピューター (%)	コンシューマー (%)	コミュニケーション (%)
'94.10-12	3,519	(8)	(16)	(17)	(59)
'95.1-3	2,743	(9)	(16)	(12)	(63)
4-6	2,179	(12)	(20)	(14)	(54)
7-9	3,095	(9)	(14)	(11)	(66)
10-12	4,120	(9)	(13)	(9)	(69)

※ () 内数値は製品構成比率

●エルナー

マレーシアを増強
車載向け生産拡大

基板大手のエルナー(株)
(横浜市港北区新横浜3—
8—1、☎0445—470
—7251)は、2016
年の全社設備投資額として
15億〜16億円(前年は17億
円)を計画している。

同社は、生産効率の向上
を狙い、マレーシア工場の
増設工事に15年内から着

棟を建設した。これにより
一貫生産工程を導入するこ
とが可能になった。なお、
15年全社投資のうち回路事
業には6割強を充てた。

マレーシア工場での生産
効率化ならびに生産能力の
拡大を目指すのは、東南ア
シアでの車載用基板の受注
が足元で拡大している動き
に対応するもの。ビルドア
ップ工法も増えてきてお
り、難易度の高い基板も受
注拡大を目指す。今後、雪